

# Co-Packaged Optics用光導波路付き基板

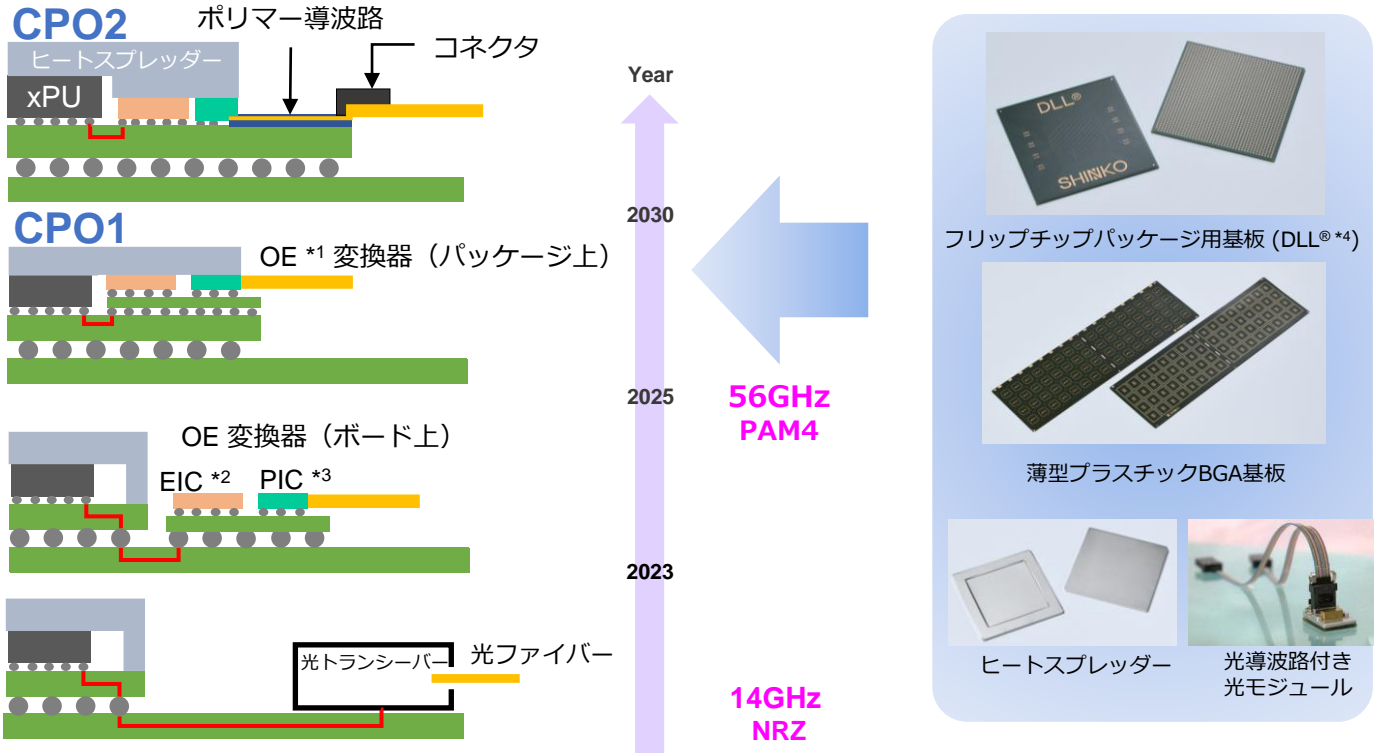
- 開発中 -

## 概要

- ・ 半導体パッケージ用基板技術をベースにした、光導波路付き高密度光伝送用基板
- ・ ポリマー光導波路はシングルモードに対応

## コンセプト

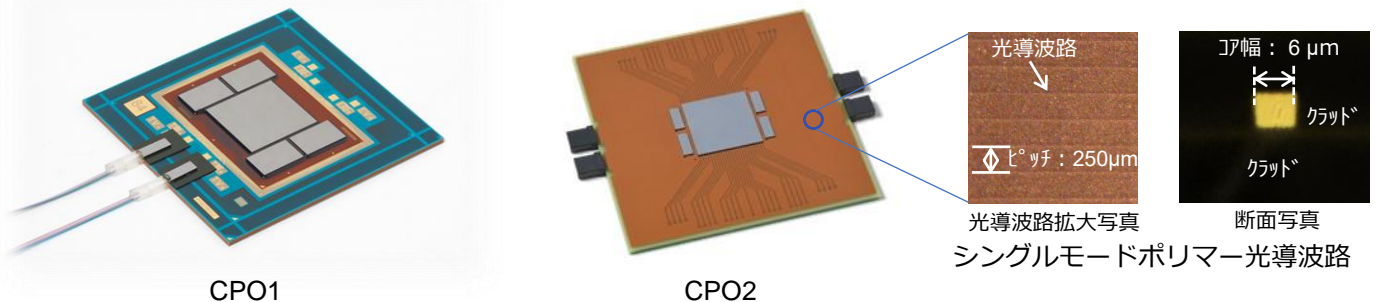
- ・ 新光電気は低消費電力で高速・大容量データ通信を可能とするCo-Packaged Optics (CPO) 技術を開発しています。



- \*1 OE : Optical-Electrical
- \*2 EIC : Electronic IC
- \*3 PIC : Photonic IC
- \*4 DLL : Direct Laser & Lamination / DLLは新光電気工業(株)の登録商標です。

## 構造

- ・ CPO1 : 半導体パッケージ端に光インターフェイス (光電変換デバイス) を配置
- ・ CPO2 : 銅配線とシングルモードポリマー光導波路を同一基板の上に配置



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町80

お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。

<https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php>



SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.

80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN

Please contact us via inquiry form on the web.

<https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php>

